



80~150°C固化低温铜浆

料号	成份	主要特点, 应用领域 Application field, Main feature
主要特点	低温铜浆	①可以丝网印刷, 点胶, 稀释后喷涂 (需加专用稀释剂 ST1001) ②在陶瓷、玻璃、PCB 等硬基材, PET、PC、PI 软基材上均可使可提供优良的导电性和薄膜粘接性 ③有着良好的印刷性、柔性和极强的附着力, 可弯折 ④薄膜开关、柔性印刷电路、键盘电路、屏蔽线路、多, 射频干扰屏蔽、RFID、玩具、学习机电路等印刷和触点印刷等领域 ⑤固化后耐温 150°C以下

产品规格书/Specification

产品/product:	低温铜浆/ Copper paste
料号/Part number:	25L-2211

- ※ **80~150°C加热固化铜浆**
- ※ **适用于柔性基材, 陶瓷, 玻璃, 金属等基材**
- ※ **铜含量高, 电阻低**
- ※ **极好的附着力**

基材 Substrate	陶瓷基板、PET、PC, 聚酯薄膜等片材 Suitable for Ceramic, Pet, PI, Pc etc	
使用方法 Method of use	250-350 mesh stainless screen 250-350 目丝网印刷	
流平 Leveling	3-5min minutes at room temperature 室温下流平 3-5 分钟 (时间根据流平的实际情况决定)	
固化 Curing conditions	80°C	60 分钟/mins
	120°C	20 分钟/mins
	150°C	15 分钟/mins
Fineness 细度	≤5μm	FOG test
Viscosity 粘度	100-180Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1°C,



深圳市赛雅电子浆料有限公司

Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

电话, 微信: 13510026516

www.sryeo.com

sales@sryeo.com

		Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1°C 粘度可根据用户实际需要调节。
固体含量 content	65-80%	银 Silver, Glue
方阻 Resistivity	≤200mΩ/□	方阻测试法 固化膜厚 10μm, 测试图形 100mm*1mm Cured film thickness 10-25μm, test pattern 100mm * 1mm
	≤100mΩ/□	四针探测法 25.4u Four-needle probe 25.4u
附着力 Adhesion	无脱落 Not fall off	3M 600#胶带 90°拉 3M 600#Tape 90°Pull

适用范围/Application:

单组分导体浆料系列, 可广泛应用于柔性印刷电路、笔记本键盘电路、射频干扰屏蔽、RFID、玩具、学习机电路印刷和触点印刷等领域, 在氧化铝陶瓷、微晶玻璃陶瓷、PET、PC 等片材上均可使用, 可提供优良的导电性和薄膜粘接性, 有着良好的印刷性、柔性和极强的附着力, 其导电性能不会因为印刷后的加工成型或产品使用时的弯曲变化发生大的偏移, 丝网印刷、喷涂均可。

使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	陶瓷基板、PET、PI 聚酯薄膜等片材 Suitable for Ceramic, Pet, PI etc
使用方法 Method of use	200-250 mesh stainless screen 200-250 目丝网印刷
流平 Levelling	3-5min minutes at room temperature 室温下流平 3-5 分钟 (时间根据流平的实际情况决定)
固化 Curing conditions	在恒温烘箱 80°C 60 分钟, 120°C 20 分钟, 150°C 10 分钟, 180°C 5 分钟 80°C, 60 mins, 120°C 20mins, 150°C 10mins, 180°C 5mins (For reference, the baking temperature and baking time can be set according to actual needs) (仅供参考, 具体烘烤温度和烘烤时间可根据实际需要设定)
稀释剂 Thinner	ST-1001

性能/Characteristics:

1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 Fineness 细度	≤8μm	FOG test
2 Viscosity	80-220Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1°C,



深圳市赛雅电子浆料有限公司

Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

电话, 微信: 13510026516

www.sryeo.com

sales@sryeo.com

	粘度		Brookfield HBT (博利飞) 粘度计, 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1°C 粘度可根据用户实际需要调节。
3	固体含量 content	65-80%	铜 Copper, Glue

2. 烧结后特性/Characteristics after curing:

在 1 烧结条件下, Check fired film produced under the conditions specified in 1),

特性 Characteristics	Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions
4 Resistivity 方阻	≤200mΩ/□	方阻测试法 固化膜厚 10μm, 测试图形 100mm*1mm Cured film thickness 10-25μm, test pattern 100mm * 1mm
	≤100mΩ/□	四针探测法 25.4u Four-needle probe 25.4u
5 硬度 Hardness	3H	铅笔硬度 Pencil hardness
6 附着力 Adhesion	无脱落 Not fall off	3M 600#胶带 90°拉 3M 600#Tape 90°Pull

保存条件, 有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-15°C 的环境温度下密封储存, 有效期为产品发货之日起六个月。

The product shall be guaranteed for 6 months after shipping date, keep tightly under at 5-15°C

包装方式/Packaging method:

标准包装, 1000g/罐, 样品可提供 200 克小罐包装

Standard package 1000g/can, if you need sample to test, available 200g with small package.